

10月30日(木) 12:50-15:05

セッションチエアマン： 藤原 健典(東レ株)・不破 保博(元ローム株)

◆ **Beyond 5G に向けてのパッケージ技術の挑戦課題**



株式会社 SBR テクノロジー  
代表取締役  
西尾 俊彦

[講演要旨]

5G が開始され、Beyond 5G の議論が始まった。総務省も日本のリードの重要性から日本企業のグローバル展開におけるリードを求める。モバイル通信の実現からそれを支える高速通信インフラ、クラウドやエッジサーバーの半導体及びパッケージの実現に対して、2D/3D 高密度化、信号高速化及び高周波化の要求特性の視点から挑戦課題を考える。

[講演者プロフィール]

1988 年 日本アイ・ビー・エム(株)に入社。世界初となったビルドアップ基板ヘフリップチップ実現の開発に従事。そのテクノロジーをウェアラブル PC などモバイル製品への適用をリードし、IBM Distinguished Engineer (技術理事)となる。

2011 年より STATSChipPAC Ltd. にて FO-WLP のプロモーションを行い、日本法人の社長を務める。  
2015 月より半導体パッケージのコンサルティングサービスを企業し、株式会社 SBR テクノロジーの代表取締役兼コンサルタントとして活動中。

◆ **先端パッケージ技術動向およびファンアウト基板への直描画技術**



SCREEN セミコンダクターソリューションズ株式会社  
フロンティア技術統轄部  
露光プロダクト部  
部長  
波多野 章人

[講演要旨]

IoT、5G、AI、自動運転、Edge-computing 等々、ここ最近よく耳にするキーワードから、今後のパッケージ技術に求められるポイントを整理し、それぞれの要求に対する直描画の活用方法について解説する。

[講演者プロフィール]

1998 年、大日本スクリーン製造株式会社に入社。技術研究所に所属し、大型フォトマスク用レーザープロッターの開発に従事。2008 年から後工程向け直描画装置の開発を担当し、現在に至る。

◆ **Micro LED ディスプレイ製造トータルソリューションの紹介**



東レエンジニアリング株式会社  
メカトロファインテック事業本部 第 1 事業部  
営業部 戦略営業チーム  
主席技師  
森 英治

[講演要旨]

本講演では、次世代ディスプレイとして期待されている Micro LED ディスプレイの生産工程について、当社検査装置、レーザーパリア装置、転写実装装置等による一貫ラインの紹介と、レーザー方式による転写工程の大幅効率化技術を紹介する。

[講演者プロフィール]

1995 年 3 月 大阪電気通信大学大学院制御機械工学専攻修士課程修了、東レエンジニアリング株式会社に入社。PDP 用蛍光体塗布装置、LCD 用 ID 露光装置(タイトラー)、次世代太陽電池用レーザーパターニング装置等の開発に従事。2019 年、Micro LED 向けレーザートランスファー装置を開発し、現在に至る。

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-1】 大学セッション ナノテクノロジープラットフォーム

【D-3】 最新接合技術を用いたパッケージングに関する材料・装置関連